

開示の要約

研磨方法および研磨装置

- 5 ウェーハなどの基板からの反射光のスペクトルのばらつきの影響を低減し、正確な膜厚を決定することができる基板の研磨方法が開示される。研磨装置は、回転する研磨テーブル上の研磨パッドに基板を押し付けて該基板の表面を研磨し、前記研磨テーブルが一回転するたびに、前記基板の表面からの反射光のスペクトルを生成し、研磨時間に沿って並ぶ複数のスペクトルから構成される三次元データを作成し、
- 10 前記三次元データに基づいて前記基板の膜厚を決定する工程を含む。

図 9